

TSOP

TSOP (薄型小外形封装) 是基于引线框架的塑封封装, 适用于各种存储器产品, 包括 SRAM、闪存、FSRAM 和 EEPROM。选择绿色物料清单是标准, 从而让器件能够符合适用的无铅和 RoHS 要求。

特色

- ▶ 铜线或金线互连, 以降低成本
- ▶ 标准 JEDEC 封装外形
- ▶ 一站式测试服务、包括条带测试选项
- ▶ 标准绿色材料 – 无铅且符合 RoHS 要求

工艺亮点

- ▶ 支持晶圆背面研磨
- ▶ 多晶粒和晶粒堆叠能力
- ▶ 采用薄膜晶粒贴装材料和内脚布线 (ILT) 的可选引脚上芯片封装 (COL)
- ▶ 标准雾面锡引脚精加工
- ▶ 在封装上使用激光打标

可靠性认证

Amkor 封装合格审定使用三个独立的生产批, 每个测试组有至少 77 个器件。所有测试均包括 JSTD-020 湿度预处理。

- ▶ 湿度敏感性特性: JEDEC 级别 1、85°C/85% 相对湿度、168 小时
- ▶ uHAST: 130°C/85% 相对湿度、无偏置、96 小时
- ▶ 温度循环: -65°C/+150°C、500 次循环
- ▶ 高温储存: 150°C、1000 个小时

服务与支持

Amkor 提供丰富的资源, 帮助客户以尽可能低的成本将优质的产品迅速推向市场。

- ▶ 定制引线框架设计
- ▶ 全封装特性
- ▶ 热、机械应力和电性能建模
- ▶ 一站式组装、测试和直接发货
- ▶ 世界级可靠性测试和故障分析

测试服务

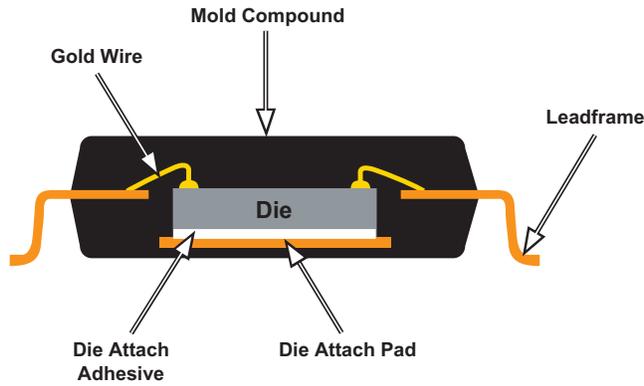
- ▶ 程序生成/转换
- ▶ 晶圆探针测试
- ▶ 耐老化性能
- ▶ 可提供 -55°C 至 +165°C 测试

发货选项

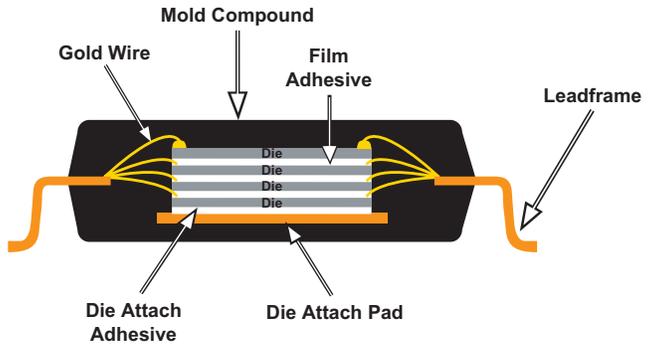
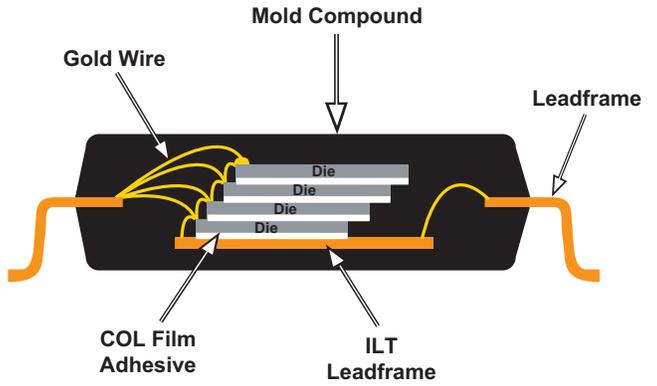
- ▶ JEDEC 外形 CS-020 薄型料盘
- ▶ 条形码
- ▶ 干燥包装
- ▶ 直接代发货

TSOP

TSOP 的横截面



堆叠 TSOP 的横截面



配置选项

TSOP 标称封装尺寸 (mm)

封装	引脚数量	单颗肩宽	封装长度	封装厚度	整体高度	引脚节距	总尺寸	JEDEC
TSOP 1	48	12.00	18.40	1.0	1.1	0.50	20.00	MO-142

访问 amkor.com 或发送电子邮件至 sales@amkor.com 以获得更多信息。



关于本文档中的信息，Amkor 对其准确性或使用此类信息不会侵犯第三方的知识产权不作任何担保或保证。Amkor 对因使用或依赖它而造成的任何性质的损失或损害概不负责，并且不以此方式默示任何专利或其他许可。本文档不以任何方式扩展或修改 Amkor 其任何产品的标准销售条款和条件中规定的保修。Amkor 保留随时对其产品和规格进行更改的权利，恕不另行通知。Amkor 名称和标志是 Amkor Technology, Inc. 的注册商标。所提到的所有其他商标是各自公司的财产。© 2019 Amkor Technology Incorporated. 保留所有权利。DS330L 修改日期：05/19

